

Patice procesoru (Socket) a čipsety

Při výběru základní desky a procesoru musí oba tyto prvky odpovídat dvěma kritériím: fyzickému (patice) a logickému (čipset). Pokud si vyberete procesor, který nepasuje do patice nebo není podporován čipsetem, počítač nebude fungovat.

1. Patice procesoru (Socket)

Patice je mechanický konektor na základní desce, do kterého se vkládá procesor. Zajišťuje fyzické uchycení a elektrické propojení procesoru s deskou.

Typy konstrukcí

Dnes se setkáváme se dvěma hlavními způsoby, jak jsou piny (kontakty) uspořádány:

- LGA (Land Grid Array):** Piny jsou umístěny **v patici na základní desce**. Samotný procesor má na spodní straně pouze kontaktní plošky. (Dnes používá Intel i AMD u patice AM5).
- PGA (Pin Grid Array):** Piny jsou přímo **na procesoru**. Patice na desce má pouze otvory, do kterých piny zapadnou. (Typické pro starší AMD AM4).

Aktuální dominantní patice

Výrobce	Patice	Podporované generace	Poznámka
AMD	AM4	Ryzen 1000 až 5000	Legendární patice s extrémní dlouhověkostí.
AMD	AM5	Ryzen 7000 a novější	Používá LGA, podporuje pouze DDR5 a PCIe 5.0.
Intel	LGA1700	Core 12., 13. a 14. gen	Hybridní architektura, podpora DDR4 i DDR5.
Intel	LGA1851	Core Ultra (2024+)	Nová patice pro nejnovější architektury.

2. Čipset (Chipset)

Čipset je sada čipů na základní desce, která řídí komunikaci mezi procesorem, pamětí, grafickou kartou a periferiemi (USB, SATA, zvuk). Čipset určuje, kolik disků můžete připojit nebo zda můžete procesor taktovat.

Rozdělení čipsetů (Tiers)

Výrobci dělí čipsety do tří základních tříd podle vybavy a ceny:

1. Základní (Entry-level):

- Intel: Hx10** (např. H610) / **AMD: Ax20** (např. A620)

- Určeno pro kancelářská PC. Omezený počet USB a PCIe linek, obvykle bez možnosti taktování.

2. Střední třída (Mainstream):

- **Intel: Bx60** (např. B760) / **AMD: Bx50** (např. B650)
- **Zlatá střední cesta.** Podpora rychlých disků, dobré chlazení napájecí kaskády, u AMD i možnost taktování.

3. High-end (Enthusiast):

- **Intel: Zx90** (např. Z790) / **AMD: Xx70** (např. X670E)
- Plná výbava, podpora pro extrémní taktování, nejvíce PCIe 5.0 linek pro více NVMe disků.

3. Na co si dát pozor při nákupu?

1. ****Zpětná kompatibilita:**** To, že procesor do patice fyzicky pasuje, neznamená, že ho čipset podporuje. Vždy zkontrolujte "CPU Support List" na stránkách výrobce desky.
2. ****Verze BIOSu:**** Starší desky mohou potřebovat aktualizaci BIOSu, aby rozpoznaly novější procesor ve stejné patici (časté u AM4 a LGA1700).
3. ****VRM (Napájecí kaskáda):**** Pokud dáváte výkonný procesor (i9 nebo Ryzen 9) do levné desky s čipsetem řady B nebo H, může se deska přehřívat a procesor bude ztrácet výkon.

Související články:

- [Procesor \(CPU\) - Podrobný rozbor](#)
- [Rozměry desek \(ATX, mATX, ITX\)](#)
- [Kompatibilita operačních pamětí RAM](#)

From:

<https://www.serviceit.cz/> - IT ENCYKLOPEDIE

Permanent link:

https://www.serviceit.cz/doku.php?id=hw:cpu_socket

Last update: **2026/01/13 14:00**

